

課題番号 : F-17-WS-0065
利用形態 : 技術相談
利用課題名(日本語) : 電鍍手法による高精度プローブカード配線パターン加工方法の開発
Program Title (English) : High precision wiring pattern process in probe card by electroforming
利用者名(日本語) : 木本軍生¹⁾、清宮政雄¹⁾
Username (English) : G. Kimoto¹⁾, M. Seimiya¹⁾
所属名(日本語) : 1) 株式会社プロブエース
Affiliation (English) : 1) ProbeAce Co., Ltd.
キーワード/Keyword : 電鍍加工、プローブカード、成膜・膜堆積

1. 概要(Summary)

プローブ針と配線を一体化したシート構造を特徴とする当社のプローブカードの研究において、プローブとしての高精度配列とバネ性及び配線の導電性の両者を満足する加工方法の課題について、早稲田大学支援機関に技術相談を行った。

その結果、プローブ特性を満足するニッケル電鍍プロセスによる加工方法について、スルファミン酸ニッケル浴による電鍍加工方法がベストであるというアドバイス、並びにその組成・条件についての詳細なアドバイスを受け、プロセスフローを見直すことにした。さらに本方法により形成されたニッケルパターン上に銅電鍍を追加することにより、本課題を解決するに至った。

2. 実験(Experimental)

<技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。>

3. 結果と考察(Results and Discussion)

<技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。>

4. その他・特記事項(Others)

なし

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし

6. 関連特許(Patent)

なし